

Title (en)
Device and method for pouring molten metal

Title (de)
Vorrichtung und Verfahren zum Vergießen von Metallschmelze

Title (fr)
Dispositif et procédé pour couler du métal en fusion

Publication
EP 1393839 A1 20040303 (DE)

Application
EP 03016364 A 20030719

Priority
DE 10237152 A 20020814

Abstract (en)
A device for casting metal melts, especially steel melts, comprises a distribution channel (1) for the metal melt, a cover (9) for covering the channel, and an inert gas supply (14a) for conveying inert gas (G) into the inner chamber (4) surrounded by the channel. An Independent claim is also included for casting metal melts using the above device.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Vergießen von Metallschmelze, insbesondere zum Vergießen von Stahlschmelze in einer Bandgießanlage, mit einer Verteilerrinne (1), in die die Metallschmelze einfüllbar ist, mit einer Abdeckung (9) zum Abdecken der Verteilerrinne (1) und mit einer Inertgasversorgung (14a) zum Fördern von Inertgas (G) in den von der Verteilerrinne (1) gemeinsam mit der Abdeckung (9) umschlossenen Innenraum (4). Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das Verfahren ermöglichen es, Metallschmelze, insbesondere Stahlschmelze, direkt zu einem Band ohne die Gefahr der Bildung von Oxid-Einschlüssen zu vergießen. <IMAGE>

IPC 1-7
B22D 11/108; **B22D 11/103**; **B22D 41/00**; **B22D 35/04**; **B22D 11/10**; **B22D 11/11**

IPC 8 full level
B22D 11/10 (2006.01); **B22D 11/103** (2006.01); **B22D 11/108** (2006.01); **B22D 11/11** (2006.01); **B22D 41/00** (2006.01)

CPC (source: EP)
B22D 11/10 (2013.01); **B22D 11/103** (2013.01); **B22D 11/108** (2013.01); **B22D 11/11** (2013.01); **B22D 41/00** (2013.01)

Citation (search report)

- [Y] US 4452434 A 19840605 - SANTANEN ONNI [FI]
- [XY] US 5004495 A 19910402 - LABATE MICHEAL D [US]
- [XY] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 067 (M - 673) 2 March 1988 (1988-03-02)
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 11 30 September 1998 (1998-09-30)
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 404 (M - 757) 26 October 1988 (1988-10-26)
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 034 (M - 1204) 28 January 1992 (1992-01-28)
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 25 12 April 2001 (2001-04-12)

Cited by
CN108463299A

Designated contracting state (EPC)
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)
EP 1393839 A1 20040303; DE 10237152 A1 20040304; PL 361583 A1 20040223

DOCDB simple family (application)
EP 03016364 A 20030719; DE 10237152 A 20020814; PL 36158303 A 20030808